

A photograph of a busy exhibition hall with many people in business attire. In the background, a sign reads "SEMICON Japan 2018" and "Smart Applications Zone".

マジックが起きる。
CONNECT | COLLABORATE | INNOVATE

SEMICON Japan 2018
2018年12月12日(水) - 14日(金) 東京ビッグサイト

出展申込み受付中

小間位置はお申込み順で選択いただきます。お早目にお問い合わせください。
Tel: 03-3222-5988 Email: jcustomer@semi.org

出展料金

通常小間(3m×3m、スペース渡し)
360,000円/小間~(会員連続出展価格、税別)

SMART Applicationsゾーンおよびパビリオン(2m×1m、基礎装飾付)
124,000円/小間~(会員連続出展価格、税別)

新展示ゾーン誕生

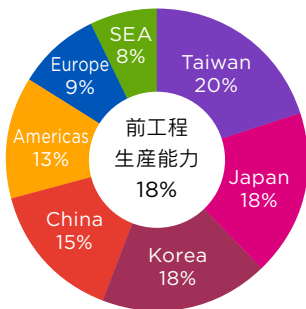
SMART
APPLICATIONS
ZONE

デジタルエコノミー時代の成長機会がここに

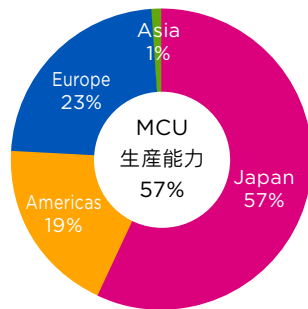
あらゆるモノとサービスがIoTでコネクタされ、大量のデータを活用するスマート社会は、半導体をはじめとするエレクトロニクスの巨大な需要を創出しています。かつてない成長ステージへの扉が開かれた今、SEMICON Japanは出展者に、新しい出会いとビジネス機会—マジックを提供します。

IoT市場が求める半導体に強い日本

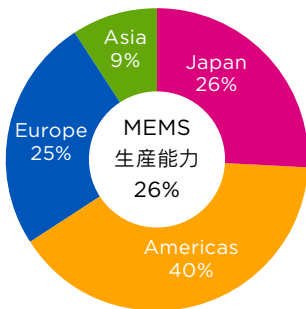
日本はこれまで培ってきた最先端製造設備を維持し、世界有数の半導体生産能力を保有しています。さらに、MCU、MEMS、パワー等、IoT市場が求めるデバイスで大きなシェアを持つ多様な半導体製品ポートフォリオを有するユニークで強力な半導体製造拠点です。



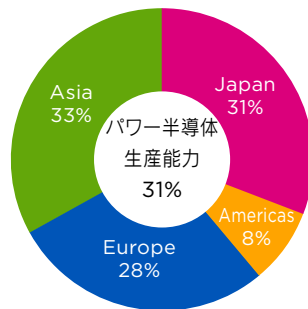
半導体前工程生産能力の地域シェア 2017



マイクロコントローラ生産能力の地域シェア 2017



MEMS生産能力の地域シェア 2017



パワー半導体生産能力の地域シェア 2017

SEMICON Japanの特長

- 750社以上が出展、67,000人が来場する、エレクトロニクス製造サプライチェーン専門展示会として世界最大級、日本随一のイベント(2017実績)
- 日本で唯一、半導体製造の前工程～後工程まで全工程の製造技術、装置、材料をカバーする大規模展
- 来場者の38%が技術職、48%がマネジメント層、61%が購買決定に関与(2017実績)
- エレクトロニクス需要をけん引するスマートアプリケーションの展示を融合
- 併催のEGセクティブフォーラム、技術セミナーが動員する1万人以上を会場へ誘導

SMART APPLICATIONS ZONE

SMART Applicationsゾーン

半導体の需要を少数のキラーアプリケーションが圧倒する時代は過去のもので、車、医療、工場、家電など多様なスマートアプリケーションが半導体を消費し、IoTを通じてビッグデータをつくりだす時代が始まりました。2014年に特別展として誕生したWORLD OF IOTは、さらに範囲を拡大し、スマートアプリケーションを展示するゾーンとしてSEMICON Japanに融合します。



スマートアプリケーションのバリューチェーンと半導体製造サプライチェーンが出会うとき、そこにマジックが起き、なにが起きるかわからないあした、ここから始まります。

SEMICON Japan 推進委員会

SEMI会員企業を代表する次の方々によってSEMICON Japanの開催は推進されています。

(敬称略、役職別社名五十音順 2018年3月1日現在)

委員長



村田機械株式会社
代表取締役社長
村田 大介

副委員長



THK株式会社
取締役副社長
今野 宏

委員

- 株式会社アドバンテスト 執行役員 営業本部 副本部長
- 株式会社アルバック 取締役専務執行役員
- 株式会社荏原製作所 執行役常務 精密・電子事業カンパニープレジデント
- JSR株式会社 上席執行役員 電子材料事業部長
- 株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ 代表取締役社長執行役員
- 株式会社ディスコ 代表取締役社長
- 東京エレクトロン株式会社 常務執行役員 FSBU GM
- 株式会社ニコン 常務執行役員 半導体装置事業部長
- 日本電子株式会社 代表取締役兼副社長執行役員 統括開発技術担当
- 伯東株式会社 取締役執行役員
- 日立化成株式会社 執行役常務 機能材料事業本部長
- 株式会社日立国際電気 執行役専務 電子機械事業部長
- 株式会社日立ハイテクノロジーズ 執行役専務 CTO 電子デバイスシステム事業統括本部長

- 阪本 公哉
- 藤山 潤樹
- 浅見 正男
- 杉本 健
- 須原 忠浩
- 関家 一馬
- 春原 清
- 馬立 稔和
- 岩槻 正志
- 北野 和信
- 森嶋 浩之
- 金井 史幸
- 木村 勝高



SEMICON Japan出展対象分野と製品

メイン展示ゾーン

前工程ゾーン

- 設計工程・設計ツール
- ウェーハ製造工程
- ウェーハプロセス工程

部品・材料ゾーン

- プロセス材料
- テスト材料
- 組み立て材料
- ガス・ケミカルと固体材料
- 基板
- パーツ・サブシステム

後工程・総合ゾーン

- 組立工程
- 試験・検査工程
- 組立・搬送装置用関連機器
- 環境関連装置
- 各種ソフトウェア・サービス

SMART Applicationsゾーン

スマートアプリケーションの要素技術

- 半導体デバイス(センサー/MEMS、パワーデバイス)
- フレキシブルハイブリッドエレクトロニクス(FHE)
- ネットワーク/ゲートウェイ
- IoTプラットフォーム/ソフトウェア/セキュリティ

スマートアプリケーション製品・技術

- スマートマニュファクチャリング
- 自動車/カーエレクトロニクス
- ウェアラブル機器/ヘルスケア機器
- ロボット
- コンシューマエレクトロニクス

製造イノベーションパビリオン

SEMICON Japanが出展対象とする全製品が対象です。次のような方々に最適な出展オプションです。

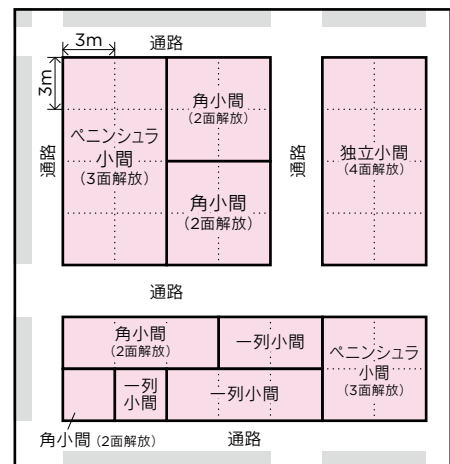
- SEMICON Japanへの初出展、または関連産業からの新規参入をされる方
- 2m×2m、あるいは2m×1mの小規模なブースで展示が可能な方

化合物半導体パビリオン

スマート社会が求める低消費電力化、小型化、高速処理化等を実現する化合物半導体デバイスの製造装置、材料、関連サービス

小間形態

	最小申込単位
一列小間	1小間
角小間	1小間 2面開放
ペニンシュラ小間	4小間 3面開放
独立小間	4小間 4面開放



装飾物の高さ制限

メイン出展ゾーン

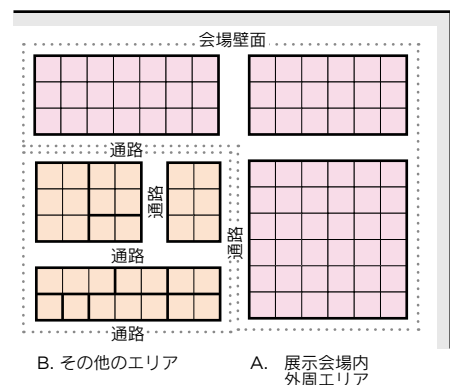
- 展示会場内 外周エリア(最後面及び最側面のみ。最前面を除く。)
4小間(6m×6m)以上の独立小間は6m以下。
それ以外は4.5m以下。
- その他のエリア 4.5m以下

SMART Applicationsゾーンおよびパビリオン

総小間面積 9 m²以上 4.5m以下

総小間面積 9 m²未満 2.7m以下

高さ制限および装飾規定は変更される場合があります。詳細は9月中旬に出展者に配布する「出展者マニュアル」にてご確認ください。



B. その他のエリア A. 展示会場内 外周エリア

開催概要

名称 SEMICON Japan
会期 2018年12月12日(水) - 14日(金)
会場 東京ビッグサイト 東展示棟・会議棟
 東京都江東区有明3-10-1
主催 SEMI
Web <http://www.semiconjapan.org/jp>

お申込み方法のご案内

出展のお申込みは、SEMICON JapanのWebサイト(www.semiconjapan.org)からオンラインで受け付けいたします。

小間位置は、お申込みの先着順に、空いているスペースから申込者が選択することができます。

2018出展料金 (税別)

メイン展示ゾーン

基本小間サイズ：9m²

(幅3m×奥行3m) スペース渡し*

	通常料金	連続出展特別料金**
SEMI会員	¥400,500	¥360,000
一般	¥540,000	¥486,000

SMART Applicationsゾーンおよびパビリオン

基本小間サイズ：9m²

(幅3m×奥行3m) スペース渡し*

	通常料金	連続出展特別料金**
SEMI会員	¥400,500	¥360,000
一般	¥540,000	¥486,000

基本小間サイズ：4m²

(幅2m×奥行2m) スペース渡し*

	通常料金	連続出展特別料金**
SEMI会員	¥178,000	¥160,000
一般	¥240,000	¥216,000

基本小間サイズ：2m²

(幅2m×奥行1m) 基礎装飾込***

	通常料金	連続出展特別料金**
SEMI会員	¥133,000	¥124,000
一般	¥164,000	¥152,000

* 社名板、床カーペット、間仕切りパネルは含まれません。

** SEMICON Japan 2017の出展者には、SEMICON Japan 2018の出展に際し、連続出展特別料金が適用されます。

*** 基礎装飾には、社名板、床カーペット、間仕切りパネル、システムカウンター、パイプ椅子、コンセント、照明が含まれます。

パッケージブース

SEMICON Japanの出展料金には、基本装飾(社名板、床カーペット、間仕切りパネル等)は含まれていません。† ご出展に最小限必要なものを揃えたパッケージブースをご用意しておりますので、ぜひご利用ください。††

† SMART Applicationsゾーンおよびパビリオンの2m×1mサイズのブースにはパッケージブースが含まれた料金設定となっています。

†† パッケージブースのお申込みは、9月上旬に出展者へご案内する「出展者専用サイト」にて受付させていただきます。

2m (間口) × 1m (奥行) × 2.7m (高)

出展料に含まれています。



2m (間口) × 2m (奥行) × 2.7m (高)

¥85,000 (税別)



3m (間口) × 3m (奥行) × 2.7m (高)

¥100,000 (税別)



パッケージブースサイズ	2m×1m	2m×2m	3m×3m
バックサイドパネル		1式	
パラベット		1式	
社名板 (W1500×H400)		日英併記 ゴシック体(黒) 1枚	
カーペット		1式 (パビリオン等では事務局指定色となります)	
展示台 (W990×D700×H770)	1台	—	—
受付台 (W900×D450×H800)	—	1台	1台
パイプ椅子		1脚	
蛍光灯 (40W)	1灯	1灯	2灯
コンセント (2口)		1個	
電気使用料		1kW	

※角小間の場合、通路側に壁面は立ちません。代わりにパラベット+社名板になります。

お問合せ

SEMIジャパン カスタマー・サービス

Tel: 03.3222.5988

Email: jcustomer@semi.org